

Opis przedmiotu zamówienia

Materiały eksploatacyjne do systemu MBE:

Podłoża CdZnTe, 5% Zn

Orientacja: (211)B \pm 0.3 deg.

Rozmiar: 20 mm x 20 mm (\pm 0,2 mm)

Grubość: 800 \pm 50 μ m

Przewodnictwo: półizolujący

Obróbka powierzchni: E.P.D. Nakagawa Etching \leq 1×10^5 cm⁻²

Powierzchnia końcowa: przód – lustro polerowane, tył – z grubsza polerowane

Ilość: 24 szt.

Podłoża GaAs

Orientacja: (211)B \pm 0.3 deg.

Rozmiar: 2" \pm 2 %

Grubość: 650 \pm 25 μ m

Przewodnictwo: półizolujący

Obróbka powierzchni: E.P.D. Nakagawa Etching \leq 1×10^5 cm⁻²

Powierzchnia końcowa: jednostronnie polerowane

Ilość: 33 szt.

Podłoża Si (N type, P doped)

Orientacja: (100) B \pm 0.5 deg.

Rozmiar: 2" \pm 2 %

Grubość: 335 \pm 20 μ m

Przewodnictwo: 0.05-0.1 ohmcm

Obróbka powierzchni: E.P.D. Nakagawa Etching \leq 1×10^5 cm⁻²

Powierzchnia końcowa: jednostronnie polerowane

Ilość: 30 szt.